

檔 號：

保存年限：

上緯國際投資控股股份有限公司 函

地址：540南投市東閔路588號

承辦人：徐翊萍

電話：049-2255420#174

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年6月14日

發文字號：上投控字第2024060005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文附件一

主旨：敬邀貴公司參與「低碳足跡熱固性複材商機論壇」，詳如說明及附件，請查照。

說明：台灣為出口導向型國家及製造代工大國，面臨歐盟、美國開徵碳關稅、碳費，各產業積極尋找低碳解決方案開創生機，工研院與台灣複材公會偕同上緯投控特舉辦「低碳足跡熱固性複材商機論壇」，號召國內產學研循環經濟專家以及複合材料先進分享淨零減碳路徑與成功案例；並廣邀台灣各產業共襄盛舉，期盼藉由跨產業的交流分享促進低碳商機發展。

- 一、時間：7/17(三)13:00~17:00，提供報名連結：<https://reurl.cc/ZeA7Da>，亦可於附件右下角，掃描QR Code進行線上報名，敬請於7/10(三)前完成報名手續，俾便後續作業。
- 二、地點：上緯集團產業創新園七樓會議廳（南投縣南投市東閔路588號）。
- 三、論壇議程詳如附件。
- 四、檢附「低碳足跡熱固性複材商機論壇簡章」一份。

正本：國立臺灣海洋大學、德育學校財團法人德育護理健康學院、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學工會、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、中國科技大學、輔仁大學學校財團法人、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、明志科技大學、明志科技大學附設進修學院、黎明技術學院、國立清華大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立中興大學、國立臺中教育大學、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、中國醫藥大學、亞洲大學、國立勤益科技大學、國立臺中科技大學、國立臺中科技大學附設空中進修學院、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、嶺東科技大學附設進修學院、中臺科技大學、中臺科技大學附設

進修學院、僑光科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、國立彰化師範大學、大葉大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立虎尾科技大學附設進修學院、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立成功大學、國立臺南大學、長榮大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、國立中山大學、國立中山大學國際金融研究學院、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、國立高雄科技大學、國立屏東科技大學、國立暨南國際大學、國立東華大學、國立宜蘭大學

副本：